

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: MPC8245/8240製品のサブストレート変更

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2011年1月6日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

Regional Marketing - Network

該当GPCN番号:

14391

変更内容:

MPC8245/8240製品のピークリフロー温度を245℃@MSL3から260℃@MSL3対応とするため、下記の変更をいたします。

- ①サブストレートのワイヤボンディングパッドのデザイン変更
- ②サブストレートパッドのニッケルメッキの厚みの変更

変更理由:

ピークリフロー温度を245℃@MSL3から260℃@MSL3対応とするため。

対象製品:

添付別紙ご参照ください。

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日： 2011年4月 予定

出荷日を特定することは困難です。ご了承ください。

変更品の見分け方:

なし。

その他:

JPCN2011-0008(14391)対象製品

MPC8245ARVV400D
MPC8245ARZU400D
MPC8245LVV266D
MPC8245LVV300D
MPC8245LVV333D
MPC8245LVV350D
MPC8245LZU266D
MPC8245LZU300D
MPC8245LZU333D
MPC8245LZU350D
MPC8245TVV266D
MPC8245TVV300D
MPC8245TVV333D
MPC8245TVV350D
MPC8245TZU266D
MPC8245TZU300D
MPC8245TZU333D
MPC8245TZU350D
PPC8245ARVV400D
PPC8245TVV266D
SC8245ARVV400D
SC8245ARVV466D
SC8245ARZU466D
SCM8245ALVV400D
SCM8245ALZU400D
SCM8245ARVV400D
SCM8245ARVV466D
XPC8240LVV200E
XPC8240LZU200E
XPC8240RVV250E
XPC8240RZU250E